

Puce A8 du prochain iPhone : Samsung est toujours en piste

Mai 2013 : des rumeurs indiquaient que les prochains processeurs d'application des futurs iPhone et iPad seraient **exclusivement gravés par TSMC** (*Taiwan Semiconductor Manufacturing Company*). La semaine dernière encore, le site chinois Commercial Times annonçait que TSMC avait commencé la production de masse de la puce A8, précisant que le fondeur taiwanais **remplaçait Samsung** dans ce rôle. La réalité devrait être toute autre.

Malgré ces rumeurs, il est en effet fort **probable que Samsung soit partie prenante dans la production de l'A8**. C'est le site *ZDNet Korea*, citant une source officielle (non nommée), qui avance l'information. L'accord porterait sur la production de masse de l'A8 dans la *fab* de Samsung située à Austin au Texas, celle-là même qui produit actuellement l'A7 embarqué dans les iPhone 5s, iPad Air et iPad Mini Retina. Si l'on en croit cette nouvelle piste, Apple a donc fait **appel à deux sociétés** pour produire son SoC A8 de nouvelle génération.

Des partenariats finalement incontournables

Samsung est un *chaebol* (conglomérat) avec une forte intégration verticale au sein de laquelle les *business unit* agissent comme des entités séparées. **La division mobile n'hésite pas à mettre en concurrence Samsung Electronics et Qualcomm** pour les SoC mobiles qui intégreront ses smartphones haut de gamme. On l'a vu encore récemment avec le Galaxy S5 dont la première déclinaison dévoilée embarque un SoC Snapdragon conçu par Qualcomm (et gravé par TSMC).

De la même manière, Samsung Electronics doit impérieusement et impérativement remplir ses *fabs* pour les rentabiliser. Il en va ainsi des toutes dernières lignes 20 nm (nanomètres) du constructeur sud-coréen. Précisément, **l'A8 sera gravé en 20 nm** dans un process TSMC que Samsung a adopté (tout comme les Exynos 5260 et 5422 récemment annoncés sont gravés par Samsung en 28 nm via un process TSMC).

TSMC avait débuté l'an passé la cinquième phase des travaux de sa *fab* 14 gigafab au South Taiwan Science Park, situé à Tainan dès avril 2012. Ces installations auraient coûté près de 17 milliards de dollars. Il s'agit de la deuxième *fab* 20 nm de TSMC. Elle est normalement opérationnelle depuis le début d'année tandis que la *fab* 12 située à Hsinchu sera opérationnelle dès 2013 pour produire des puces gravées en 20 nm.

Pour Apple, **une production bipartite ne peut être que bénéfique**. En cas de problème technique dans une *fab* avec l'un des acteurs, la production n'est pas intégralement stoppée. De surcroît, multiplier les sources permet de faire pression sur les prix.

L'A8 encore mystérieux

On ne sait pas encore ce que le SoC A8 réservera. Côté processeur, il s'agira toujours d'un **modèle**

64 bits compatible avec le jeu d'instructions ARMv8 alors que le processeur graphique pourrait être un quadri cœur d'Imagination Technologies (le PowerVR GX6450 semble être un candidat tout désigné).

Apple pourrait dévoiler son prochain iPhone au troisième trimestre 2014. Il pourrait s'agir du premier smartphone à intégrer une puce gravée en 20 nm.

Voir aussi

[Silicon.fr étend son site dédié à l'emploi IT](#)

[Silicon.fr en direct sur les smartphones et tablettes](#)